证券代码：688037　　证券简称：芯源微　　公告编号：2021-041

沈阳芯源微电子设备股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”、“公司”）编制了截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

根据公司第一届董事会第六次会议和 2019 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2335 号）同意注册，公司于 2019 年 12 月 10 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2100 万股，每股发行价为 26.97 元，应募集资金总额为人民币 566,370,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）60,625,896.22 元（其中保荐承销费（不含增值税）48,246,650.94 元已在募集资金中扣除）后，实际募集资金净额为 505,744,103.78 元，实际到账金额为 518,123,349.06 元。该募集资金已于 2019 年 12 月 10 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8294 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 12 月 11 日，公司分别与中信银行股份有限公司沈阳分行、中国建设

银行股份有限公司沈阳城内支行、招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，分别在中信银行沈阳和平支行（账号 8112901012900643057 ）、中国建设银行沈阳城内支行（账号 21050139000800001255）、招商银行沈阳浑南西路支行（账号 124904600110111）开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司对募集资金采取了专户存储管理。对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至 2021 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金余额（含银行理财）为 270,972,261.64 元。前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

银行名称	银行帐号	账户类别	初始存放金额（元）	余额（元）
中信银行沈阳和平支行	8112901012900643057	活期	139,182,400.00	838,523.19
	8112901032700768351	通知存款		21,000,000.00
	8112901111700761928	结构性存款		50,000,000.00
中国建设银行沈阳城内支行	21050139000800001255	活期	238,607,300.00	1,876,179.79
招商银行沈阳浑南西路支行	124904600110111	活期	140,333,649.06	12,257,558.66
辽宁沈抚农村商业银行	29032900000000000005	活期		185,000,000.00
合　计			518,123,349.06	270,972,261.64

注：初始存放金额包括部分发行费用 12,379,245.28 元。扣除发行费用后的募集资金净额为 505,744,103.78 元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

高端晶圆产业化项目募集资金承诺投资金额 23,860.73 万元，截至 2021 年 3 月 31 日实际投资总额 6,140.33 万元；

高端晶圆处理设备研发中心项目募集资金承诺投资金额 13,918.24 万元，截

至 2021 年 3 月 31 日实际投资总额 7,123.93 万元。

上述募集资金项目截至 2021 年 3 月 31 日的实际投资总额与承诺形成差异的主要原因是：公司上述项目正处于投入建设中，尚未达到预定可使用状态。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、闲置募集资金情况说明

在保证募集资金项目及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司于 2020 年 12 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款等银行产品尚未到期赎回的具体情况如下：

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	年化收益率	备注
中信银行沈阳和平支行	银行	保本浮动收益	5,000.00	闲置募集资金	2021 年 1 月 25 日	2021 年 4 月 30 日	投资理财	2.75%	
中信银行沈阳和平支行	银行	7 天通知存款	2,100.00	闲置募集资金			投资理财	2.025%	
辽宁沈抚农村商业银行	银行	活期存款	18,500.00	闲置募集资金			投资理财	—	

尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

不适用。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

八、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。公司定期报告参见下表：

发布日期	名称	报告期间
2020 年 4 月 25 日	沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019 年度
2021 年 3 月 20 日	沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2020 年度

十、上网公告附件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]110Z0184 号）。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2021 年 6 月 12 日

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：沈阳芯源微电子设备股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额：50,574.41						已累计使用募集资金总额：13,264.26				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
						2019 年：0.00				
变更用途的募集资金总额比例：-						2020 年：10,786.68				
						2021 年 1-3 月：2,477.58				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高端晶圆处理设备产业化项目	高端晶圆处理设备产业化项目	23,860.73	23,860.73	6,140.33	23,860.73	23,860.73	6,140.33	17,720.40	2022 年 6 月 30 日
2	高端晶圆处理设备研发中心项目	高端晶圆处理设备研发中心项目	13,918.24	13,918.24	7,123.93	13,918.24	13,918.24	7,123.93	6,794.31	2022 年 3 月 31 日